

Z-Paster™100-20-11S系列产品是一种不含硅氧烷成分的高性能、兼容的导热材料，作用是填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙完成热的传递。适合使用在基于硅树脂的衬垫的应用场合，它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。

其優異的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。

特性

- 》不含硅氧烷成分
- 》符合ROSH标准
- 》良好的热传导率: **2.0 W/mK**
- 》高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

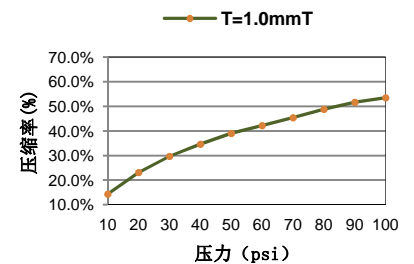
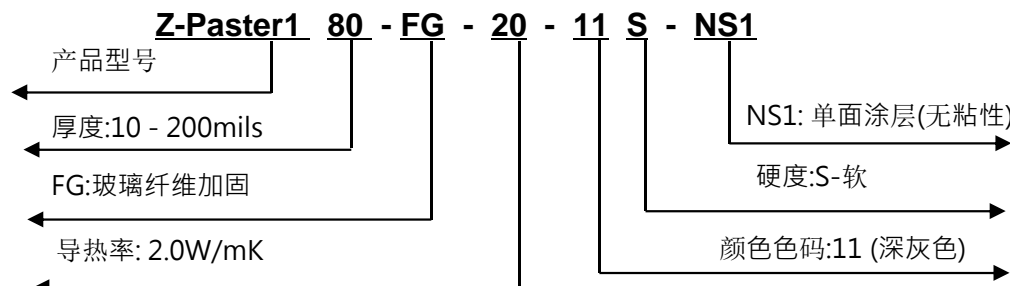
应用

- 》散热器底部或框架
- 》电源与车用蓄电电池
- 》LED电视 LED灯具
- 》SFP光模块
- 》微型热管散热器
- 》机顶盒
- 》充电桩
- 》RDRAM内存模块
- 》有机硅敏感应用
- 》医疗设备

Z-Paster100-20-11S 系列特性表

颜色	深灰色	Visual	击穿电压(T= 1mm 以上)	>5000 VAC	ASTM D149
结构&成份	不含硅氧烷 金属氧化物填充	*****	介电常数	5.5 MHz	ASTM D150
导热率	2.0 W/mK	ASTM D5470	体积电阻率	6.0X10 ¹³ Ohm-meter	ASTM D257
硬度	50 Shore 00	ASTM 2240	使用温度范围	-20 To 125 °C	*****
比重	2.65 g/cc	ASTM D297	总质量损失 (TML)	0.30%	ASTM E595
厚度范围	0.010"-0.200" (0.25mm-5.0mm)	ASTM D374	防火等级	94 V0	等同于

产品型号编码说明:



标准厚度:

0.010-inch to 0.200-inch (0.25mm to 5.0mm)

选项:

特殊NS1处理后可以产品单面无粘性

如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网：<http://www.ziitek.com>



导热灌封胶 | 相变化材料 | 导热矽胶布 | 导热膏 | 导热双面胶 | 导热硅胶片 | 陶瓷散热片 | 石墨片 | 导热塑料

加拿大:
Tel: +001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

台湾:
Tel: +886-2-22771007
Fax: +886-2-22771075
E-mail: jerry@ziitek.com.tw

东莞:
Tel: +86-769-38801208
Fax: +86-769-83791290
E-mail: angus@ziitek.com

昆山:
Tel: +86-512-57816297
Fax: +86-512-57816327
E-mail: kelvin@ziitek.com

成都:
Tel: +86-28-62379168
Fax: +86-28-62379168
E-mail: david_cd@ziitek.com